

苏州国芯科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2023 年第三季度业绩说明会)

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2023-019

| | |
|----------------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称 | 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的全体投资者 |
| 时间 | 2023 年 11 月 7 日 14:00 至 15:00 |
| 地点 | 线上交流 |
| 上市公司参加人员姓名 | 董事长：郑苙先生； 董事、总经理：肖佐楠先生； 董事会秘书：黄涛先生； 财务总监：张海滨先生； 独立董事：张薇女士。 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>2023 年 11 月 7 日 14:00 至 15:00，公司在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年第三季度业绩说明会。公司董事长郑苙先生首先致词，向广大投资者报告了公司 2023 年第三季度经营情况。随后，公司管理层与投资者进行了线上交流。主要内容如下：</p> <p>1、请详细介绍一下公司的 RAID 芯片，既然对标大厂博通，公司的的几代产品相对于友商的竞争力以及未来的规划展望。</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司成功研发 Raid 控制芯片 CCRD3316，支持独立 SATA3.0 接口达到 16 个，DDR 性能频率提升至最高可达 1600MHz，优化并增加 Raid 算法引擎达 4 组，增强了应对异常处理的掉电保护和恢复机制，同时对硬盘硬件兼容性进行了改善。该产品上行接口兼容 PCIE3.0 标准，</p> |

实现数据的高可靠、高效率存储及传输，为客户提供灵活可靠、大容量存储资源。基于该款芯片产品开发的 Raid 卡具有以下特点：基于高性能国产 C*Core C8000 CPU，具有较强的数据处理能力；全面的 Raid 数据保护机制，提供 RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD 模式；支持掉电保护和恢复功能；适配国产阵列管理软件。CCRD3316 的性能与 LSI 的 9361 系列相当，可实现同类产品的国产化替代，打破长期以来 Raid 控制芯片被国外公司垄断的局面。

磁盘冗余阵列目前重要的功能在于，当阵列中任意一个硬盘发生故障时，仍可读出数据，在数据重构时，可将经计算后的数据重新置入新硬盘中。Raid 控制芯片及阵列卡存储系统面向服务器和信创存储设备应用，支持机械硬盘或 SSD 固态存储盘，对于重要数据起到了保护和恢复作用，在 AI 服务器、存储服务器和信创存储设备等领域有广泛的应用。

目前相关 Raid 芯片和板卡方案已经在 10 余家国内重点客户进行应用测试，总体反馈比较好。公司将全力以赴推进 Raid 芯片和板卡的市场推广工作，尽快实现市场应用，实现收入。

同时，公司正在基于自主高性能 RISC-V CPU 研制开发第二代更高性能的 Raid 芯片，目前各项工作进展顺利，争取今年年底流片，未来有望达到国际主流 Raid 芯片的性能。明年公司规划进行第三代更高性能 Raid 芯片的开发。Raid 芯片是服务器中广泛应用的一个重要芯片产品，长期以来被国外公司垄断，急需实现国产化替代。谢谢！

2、请问香港应科院有把现有 NPU 相关的技术转移到国芯科技吗？国芯科技准备与对“Heterogenous AI Accelerator Platform”（异构 AI 加速器平台）项目进行投资吗？能简要说下进展吗？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！公司已与香港应科院签署了合作备忘录及项目研发支持协议书，双方将建立“香港应科院-苏州国芯新型 AI 芯片联合研究实验室”，国芯科技将于未来三年投入资金以支持下一代人工智能（AI）芯片技术，香港应科院先把现有 NPU 相关的技术转移到国芯科技，协助其在 AI 芯片领域推出新产品。此外，国芯科技将对“Heterogenous AI Accelerator Platform”（异构 AI 加速器平台）项目进行投资，该项目旨在合作研发下一代 AI 芯片以及神经网络处理器等产品，该技术将用于国芯科技的汽车电子、工

业控制和机器人应用领域的 AI 芯片开发。

目前，公司已与香港应科院开展实质性的合作，香港应科院已将 NPU 相关技术转移至公司，未来双方将进一步开展新一代 NPU 的研发合作。谢谢！

3、请问公司汽车芯片需求是否改善？公司成功开发了很多车规级芯片，市场是否接受，订单是否在持续增加？公司对四季度及明年汽车芯片订单方面有什么期望吗？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！今年汽车电子领域整体面临去库存的压力，汽车电子芯片总体需求相对不足，对公司短期业绩造成一定的压力，但汽车电子芯片国产化替代总的趋势不变，汽车产业向电动化、智能化和网联化的转变愈发强烈，其中新能源车对于芯片的需求会更加旺盛。公司的优势是：（1）客户群体比较多也比较强，目前开拓的整机客户及最终产品应用基本覆盖了国内一线头部厂商，包括比亚迪、奇瑞、吉利、上汽、长安、一汽、东风和长城等整机厂商，包括埃泰克、恒润、科世达等模组厂商；（2）公司在汽车电子芯片已经系列化布局，新品研发比较多，而且公司的汽车电子芯片产品主要集中在 MCU、SoC 和数模混合芯片等车用核心芯片系列方面，以中高端 MCU、SoC 为主。截至 2023 年 9 月 30 日，公司已在汽车车身和网关控制芯片、动力总成控制芯片、域控制芯片、新能源电池管理芯片、车联网安全芯片、数模混合信号类芯片、主动降噪专用 SoC 芯片、线控底盘芯片、仪表芯片、安全气囊芯片、辅助驾驶处理芯片和智能传感芯片等 12 条产品线上实现系列化布局，拓展汽车电子芯片产品的宽度和深度。在汽车车身及网关控制、动力总成、域控制、线控底盘、车联网信息安全等领域均实现量产装车。截至 2023 年 9 月 30 日，公司的汽车电子芯片定点开发项目进一步增加至 78 个，其中开始实现量产的项目为 25 个，未来公司的汽车电子芯片产品的市场随着相关汽车电子芯片的软件开发、测试、验证的顺利推进会进一步拓展。谢谢！

4、如何看待大基金持续减持行为？

答：尊敬的投资者，您好！大基金减持系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致实际控制人的变化。谢谢！

5、请教郑董，公司汽车电子芯片已有 78 个项目实现 design in，进入量产的汽车电子项目为 25 个，请展开介绍一下主要的应用领域是哪些方面？在

汽车芯片方面公司的远景规划是怎么样的？

答：尊敬的投资者，您好！截至 2023 年 9 月 30 日，公司汽车电子芯片已在客户中实现 78 个定点开发项目的 design in，其中开始进入量产的有 25 个，主要应用领域包括车身和网关控制、动力总成控制、域控制、线控底盘、车联网安全、安全气囊、新能源电池管理等。公司已经在 12 条汽车电子产品线中布局相关芯片的开发，未来将进一步扩展应用领域，希望能以更为丰富的产品群服务好客户，实现国产化替代。谢谢！

6、请问：1、公司 Raid 芯片国内市场空间大吗？国产替代空间大吗？什么时候能量产？2、公司合作开发 GPU 市场空间多大？国产替代潜力大吗？预计什么时候上市？3、公司与头部机器人公司签订机器人合作协议了吗？合作前景如何？烦请逐一回复，非常谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！（1）公司成功研发 Raid 控制芯片 CCRD3316，支持独立 SATA3.0 接口达到 16 个，DDR 性能频率提升至最高可达 1600MHz，优化并增加 Raid 算法引擎达 4 组，增强了应对异常处理的掉电保护和恢复机制，同时对硬盘硬件兼容性进行了改善。该产品上行接口兼容 PCIE3.0 标准，实现数据的高可靠、高效率存储及传输，为客户提供灵活可靠、大容量存储资源。基于该款芯片产品开发的 Raid 卡具有以下特点：基于高性能国产 C*Core C8000 CPU，具有较强的数据处理能力；全面的 Raid 数据保护机制，提供 RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD 模式；支持掉电保护和恢复功能；适配国产阵列管理软件。CCRD3316 的性能与 LSI 的 9361 系列相当，可实现同类产品的国产化替代，打破长期以来 Raid 控制芯片被国外公司垄断的局面。目前相关 Raid 芯片和板卡方案已经在 10 余家国内重点客户进行应用测试，总体反馈比较好。公司将全力以赴推进 Raid 芯片和板卡的市场推广工作，尽快实现市场应用，实现收入。（2）公司和参股公司智绘微电子联合开发的 GPU 已经完成设计，目前已经流片回来，正在进行测试验证工作。该款 GPU 产品主要瞄准桌面办公和图形工作站等应用需求。（3）公司将机器人芯片应用作为未来公司发展的一个新增长点来进行规划，但目前尚处于初级阶段，公司已与相关头部机器人公司签订合作协议，拟共同开展智能机器人芯片的研发和产业化应用，具体机器人芯片的产品规格尚在和客户的沟通交流中。谢谢！

7、请问：1、公司三季度在手订单多少？环比及同比增长如何？2、请问 CRV4AI 芯片、CRV7AI 芯片预计什么时候会出来？谢谢！3、公司与香港应科院签署了合作开发 AI 芯片的协议吗？合作前景如何？烦请逐一回复，非常谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！有关公司经营数据情况请持续关注公司披露的定期报告、临时报告等相关公告。基于 CRV4AI CPU 和 CRV7AI CPU 的 SoC 芯片正在发展过程中。公司已经与香港应科院签署了合作备忘录及项目研发支持协议书，双方将建立“香港应科院-苏州国芯新型 AI 芯片联合研究实验室”，国芯科技将于未来三年投入资金以支持下一代人工智能（AI）芯片技术，香港应科院先把现有 NPU 相关的技术转移到国芯科技，协助公司在 AI 芯片领域推出新产品。此外，国芯科技将对“Heterogenous AI Accelerator Platform”（异构 AI 加速器平台）项目进行投资，该项目旨在合作研发下一代 AI 芯片以及神经网络处理器等产品，该技术将用于国芯科技的汽车电子、工业控制和机器人应用领域的 AI 芯片开发。谢谢！

8、请问肖董，预计四季度毛利是否继续下滑？何时能企稳回升，对因市场竞争加剧和晶圆等生产成本增加导致的毛利率下滑，公司有何应对之策？

答：尊敬的投资者，您好！四季度经营业绩情况请持续关注公司披露的定期报告、临时报告等相关公告。公司将进一步加强供应链的管理，同时持续创新，积极开发高价值的芯片产品。感谢您对公司的关心！

9、国芯作为国内自主研发汽车芯片最早的公司之一，目前客户使用公司车联网安全芯片的应用模组目前已开始进入赛力斯汽车供应链，华为问界会给公司带来多少的业务成长空间？还有哪些产品即将进入赛力斯供应链？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！公司的车联网安全芯片已经通过公司 Tier1 模组客户的应用测试，客户使用公司车联网安全芯片的应用模组目前已开始进入赛力斯汽车供应链。谢谢！

10、请问肖总，从友商的公开信息披露看，信息安全领域显示出比较明显的复苏情况，国芯是否也在订单方面有感受到？展望一下 Q4 以及明年上半年，安全领域产品的情况。谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！有关公司信创和信息安全领域四季度经营业绩情况请持续关注公司披露的定期报告、临时报告等相关公告，公司将致力于提升公司的长期价值，专注研发和市场拓展，持续创新，努力用良好的经营业绩回报投资者，公司有信心保持信创和信息安全领域业务的健康发展。感谢您对公司的关心！

11、烦请郑董展开介绍一下公司与参股公司智绘微电子联合投资和开发 GPU 芯片目前的进展情况以及未来的规划方向？

答：尊敬的投资者，您好！智绘微电子为公司的参股公司，公司正在和智绘微电子合作，联合投资和开发 GPU 芯片，该 GPU 芯片已完成设计，目前已经流片回来，正在测试验证中，未来将以国芯科技和智绘微双品牌进行市场销售。谢谢！

12、公司将汽车电子芯片事业部更名为汽车电子和机器人芯片事业部，机器人芯片的研发进展能介绍一下吗？未来的规划是会进行重点投入开发该领域吗？主要方向是人工智能还是机器人部件。

答：尊敬的投资者，您好！公司将汽车电子芯片事业部更名为汽车电子和机器人芯片事业部，主要考虑是一方面苏州已成为我国机器人技术研发和产业化应用的重要基地，公司有机会就近开展客户服务；另一方面公司在汽车电子芯片等领域的技术积累诸如多核 CPU、NPU、高可靠接口 IP 和功能安全设计技术等，都可以在未来机器人芯片中获得应用，以提升机器人芯片的安全性和可靠性。公司将机器人芯片应用作为未来公司发展的一个新增长点来进行规划，但目前尚处于初级阶段，公司已与相关头部机器人公司签订合作协议，拟共同开展智能机器人芯片的研发和产业化应用，具体机器人芯片的产品规格尚在和客户的沟通交流中。谢谢！

13、随着边缘计算越发受到重视，麻烦郑董介绍一下国芯在 NPU 领域的布局和进展，以及公司在该领域未来的规划。谢谢

答：尊敬的投资者，您好！公司在 NPU 领域的规划如下：（1）与具有领先技术的科研院所如香港应科院合作开发新一代 NPU AI 芯片技术，未来公司将在基于新的 NPU 技术继续发展工业控制和生物特征识别领域的高性能端 AI 芯片；（2）未来将寻求高性能计算和人工智能芯片技术与公司汽车电子芯

片产业深度融合，如公司规划与百度控股的昆仑芯合作开发智能驾驶 AI 芯片等，争取在汽车高性能计算和人工智能芯片方面取得新成绩。感谢您对公司的关心！

14、公司新一代汽车电子 MCU 产品“CCFC3007PT”下游的主要应用场景和目标客户是哪些？在众多国产 MCU 产品中的独特竞争力有哪些方面？

答：尊敬的投资者，您好！新一代汽车电子 MCU 产品“CCFC3007PT”于今年 10 月在公司内部测试中获得成功，目前，该芯片已经给客户送样并开展定点项目模组开发和测试。公司成功研发的汽车电子 MCU 新产品 CCFC3007PT 是基于公司自主 PowerPC 架构 C*Core CPU 内核研发的新一代适用于汽车电子动力总成、底盘控制器、动力电池控制器以及高集成度域控制器等应用的多核 MCU 芯片，是基于客户更高算力、更高信息安全等级和更高功能安全等级应用需求而开发的全新多核架构芯片。该芯片基于 40nm eFlash 工艺开发和生产，相对于同系列的 CCFC3008PT 芯片,通信 LIN 增加到 16 路、MCAN 增加到 12 路，芯片的存储空间 Flash 容量增加到 12M 字节，数据存储最高配置 Flash 最高可达 512K 字节，内存空间 SRAM 增加到 1536K 字节。另外，该芯片优化了 SDADC 模块及相应的数字滤波模块，使其更适合电机控制，还增加了 I2S（2 路）用于连接音频设备；CCFC3007PT 芯片按照汽车电子 Grade1 等级、信息安全 Evita-Full 等级、功能安全 ASIL-D 等级进行设计和生产，具备高可靠性和高安全性，可以应用于苛刻的使用场景，从而增加了产品的应用覆盖面，封装形式包括 BGA416/BGA292/LQFP216 等，可以广泛应用于汽车动力总成、底盘控制、动力电池控制器和高集成度的域控制器等领域的目标客户。谢谢！

15、请问肖董，目前云-端信息安全芯片设计及产业化项目、基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目投资进度具体情况是怎样的？

答：尊敬的投资者，您好！云-端信息安全芯片设计及产业化项目、基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目均在积极推进中，总体进展顺利，具体请详见公司披露的定期报告和临时报告。谢谢！

| | |
|--------------|-------------|
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2023 年 11 月 |